

Anmeldung

Zur Anmeldung senden Sie bitte diese Seite ausgefüllt per Fax an:
(0711) 685-83705

Hiermit melde ich mich zum Workshop "Innovative Anwendungen der MID-Technik" am 09.10.2013 in Stuttgart an.

Teilnahmegebühr: EUR 280,- inkl. MwSt

Name, Vorname, Titel:	
Firma, Institut, Abt.:	
Straße, Postfach:	
Land, PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax:	
E-Mail:	
Datum:	
	Unterschrift:

Hahn-Schickard-Gesellschaft
Institut für Mikroaufbautechnik
(HSG-IMAT)

Allmandring 9 b
70569 Stuttgart

07/13

Informationen

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bitte melden Sie sich über www.hsg-imat.de/MID-Workshop an. Alternativ können Sie für Ihre Anmeldung eine E-Mail mit allen Angaben auf dem Anmeldeabschnitt an Frau Bellezer (bellezer@hsg-imat.de) senden oder diese Seite als Fax-Formular verwenden. Sie erhalten eine Rechnung, die gleichzeitig als Anmeldebestätigung gilt.

Teilnahmegebühr

280,- EUR inkl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Mittagsbuffet, Pausengetränke und Workshop-Unterlagen.

Wir behalten uns vor, bei einem Rücktritt innerhalb 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn eine Pauschale von 20% und innerhalb 8 Tagen die volle Teilnahmegebühr zu berechnen.

Allgemeine Hinweise

Gemäß § 33 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass wir Ihre Anschrift in einer Datei speichern.

Anreise

Hotelinformationen und eine Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung/Rechnung.

Am Veranstaltungstag ist der Empfang ab 8:15 Uhr für Sie bereit. Dort erhalten Sie die Workshop-Unterlagen.

Organisation

Hahn-Schickard-Gesellschaft
Institut für Mikroaufbautechnik (HSG-IMAT)
Allmandring 9 b
70569 Stuttgart

Fragen

Prof. H. Kück
Tel.: (0711) 685-83711
Carmen Bellezer
Tel.: (0711) 685-83712
Fax: (0711) 685-83705
E-Mail: bellezer@hsg-imat.de

Workshop



Innovative Anwendungen der MID-Technik

Termin:

Mittwoch, 09.10.2013

Registrierung: 8:15 Uhr

Beginn: 9:00 Uhr

Ort:

**Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart**

Veranstalter:

**Hahn-Schickard-Gesellschaft
Institut für Mikroaufbautechnik
(HSG-IMAT)**

zusammen mit dem

**Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg**



Zum Workshop

Nach meinen Beobachtungen interessieren sich derzeit so viele Firmen wie noch nie für die MID-Technik. Dabei spielt die MID-Technik ihre Stärken insbesondere dort aus, wo es um hohen Miniaturisierungsgrad in Kombination mit hoher Dichte verschiedenster Funktionen geht. Seitens der Beleuchtungstechnik ist die Nachfrage nach MID in den letzten Jahren besonders groß. Um den Anforderungen nach guter Wärmeleitfähigkeit und ansprechender dekorativer Erscheinung gerecht zu werden, ist die Entwicklung entsprechender Thermoplaste und Lacke für das LPKF-LDS[®]-Verfahren im vollen Gang. Weiterhin wurde bei der LPKF-LDS[®]-Technik begonnen, die Leiterbahndichte in den Ultra-Fine-Pitch-Bereich weiter zu entwickeln. Was die Materialien angeht, so gibt es im HSG-IMAT auch erste sehr viel versprechende Ansätze, duromere Werkstoffe, wie sie vom Chip-Packaging und von besonders temperatur- und chemikalienbeständigen Kunststoffbauteilen bekannt sind, mit Leiterbahnsystemen zu versehen. Aufgrund der hohen Füllgrade und der geringen Wandstärken kann mit Duromeren eine deutlich bessere Wärmeableitung als mit Thermoplasten erreicht werden. Noch höhere Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit sowie mechanische und chemische Robustheit können keramische Träger bieten, wo es erste Ergebnisse zur laserinduzierten chemischen Metallbeschichtung gibt. Darüber hinaus zeigen die Drucktechniken ihr großes Potenzial für die Generierung von 3D-Leiterbildern und Sensorelementen immer deutlicher. Seitens der Fertigungstechnik bietet die Rolle-zu-Rolle Verarbeitung von MID eine effiziente Lösung bei großen Stückzahlen. Die automatisierte 3D-Bestückung der MID-Baugruppen zeigt hervorragende Resultate hinsichtlich 3D-Fähigkeit und Genauigkeit.

So bietet Ihnen der diesjährige MID-Workshop, welchen HSG-IMAT zusammen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg veranstaltet, wieder ein spannendes Programm mit neuesten Informationen aus der Industrie zur Fertigung von MID in Serie und zu neuesten technologischen Entwicklungen bei 3D-Schaltungsträgern.

Prof. Heinz Kück

Programm

8:15 Registrierung

9:00 Eröffnung

Prof. H. Kück,
Universität Stuttgart und HSG-IMAT

Grußworte

Ministerialdirigent G. Leßnerkraus,
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg
Dr. K. Funk, Spitzencluster MicroTEC Südwest

Einführung

Prof. H. Kück

9:30 LDS-Technik

Trends, Herausforderungen und Lösungen – 3D-MID Technologie

N. Bachnak, Cidor Technologies Ltd.

Neue LDS Thermoplaste

M. Wuchter, Ensinger GmbH

Möglichkeiten des LDS-Coatings von LPKF

Dr. W. John, LPKF Laser & Electronics AG

10:30 Kaffeepause

11:00 Neue Prozesse für 3D-Schaltungsträger

Selektive Kunststoffmetallisierung mittels Primer – Technologie

S. Glöde, Lüberg Elektronik GmbH & Co.
Rothfischer KG

Temperaturbeständige Duroplaste für MID Anwendungen

M. Walcher, RASCHIG GmbH

Laserstrukturierung von robusten 3D- Schaltungsträgern

E. Ermantraut, IFM Universität Stuttgart

Drucken von Schaltungen und Sensoren auf 3D-Bauteilen

B. Polzinger, HSG-IMAT

Programm

12:30 Mittagspause

14:00 Anwendungen und Produkte

Innovative Serienapplikationen im 3D- Format

U. Remer, 2E mechatronic GmbH & Co. KG

Sensorträger für eine Großbildkamera

F. Wittwer, HARTING AG Mitronics

Autostereoskopisches Großformat-Display

J. Reitterer, TriLite Technologies GmbH

Entwicklung einer innovativen Plattform für bioanalytische Anwendungen

Dr. M. Dickerhof, IGEDI GmbH

15:20 Kaffeepause

15:50 Fertigungstechniken

Rolle-zu-Rolle-Fertigung von MID- Baugruppen

S. Schulz, A. Raymond GmbH & Co. KG

Rolle-zu-Rolle- Metallbeschichtung von MID

B. Endres, Gramm Technik GmbH

3D-Mikromontage in der HSG-IMAT TransferFab

Dr. U. Keßler, HSG-IMAT

Schlusswort

17:00 Ende des Workshops